



VIA Technologies, Inc.

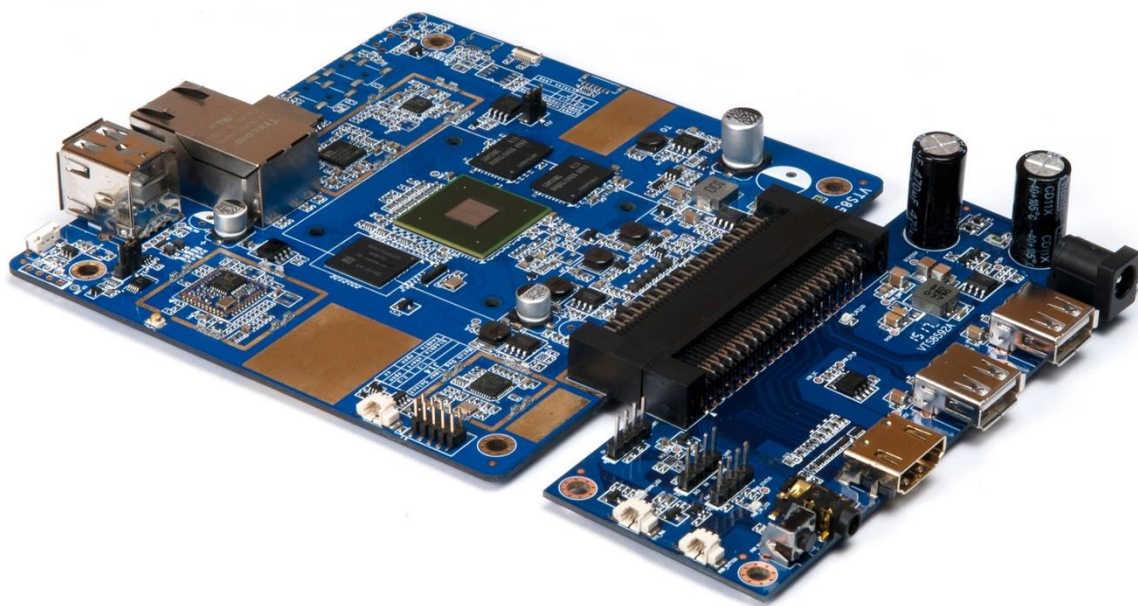
531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Embedded World 2017 において VIA VTS-8589 OPS Board を発表

— 柔軟で超小型のモジュールを、Embedded World 2017 VIA ブースにて披露 —

2017年3月10日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、本日3月10日、新製品VIA VTS-8589 OPS ボードを、ドイツ・ニュルンベルグにおいて3月14日～16日まで開催される2017 Embedded World Exhibition and Conferenceにて初披露すると発表いたしました。VIAブースは、Nuremberg Exhibition Center Hall 2の#2-55です。

IntelのOpen Pluggable Specification (OPS)に準拠したVIA VTS-8589は、追加の電源、接続性、あるいは場所を必要とせず、OPS互換のディスプレイにインストールすることができます。また、テスト・開発期間の短縮のため、本ボードはVTS-8592 OTS I/Oカードと組み合わせて使うことも可能です。このI/Oカードには、HDMIポート、2つのUSB 2.0ポート、1つのオーディオジャック、およびリセット用と電源用のボタンが装備されています。



「OPS互換ディスプレイへのシームレスなアップグレード手段を提供するVIA VTS-8589は、さらにすぐれた柔軟性を当社のデジタルサイネージのポートフォリオに与えています」と、VIA Technology Inc. 国際マーケティング担当VPのリチャード・ブラウンは語ります。「高度に統合された低電力設計により、本ボードは、もっとも要件の厳しいデジタルサイネージのアプリケーションに必要とされるすべての性能、機能、および信頼性を提供します」

VIA、Embedded World 2017 において VIA VTS-8589 OPS Board を発表

2/3

1.0GHz NXP i.MX 6QuadPlusまたは1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoCのどちらかを装備するVIA VTS-8589は、豊富なマルチメディア、入出力、そして接続機能を、超小型フォームファクターで実現しています。具体的には、8GB eMMC Flashメモリ、2GB DDR3 SDRAM、オンボードのWi-Fi、ギガビットイーサネット、1つのMicro SDカードスロット、そして2つのUSB 2.0ポートが搭載されています。OPS接続端子としては、1つのHDMI、2つのUSB 2.0ポート、1つのUART、GPIO、オーディオ、および12~19V電源端子が用意されています。

VIA VTS-8589は、最適化されたLinux BSPを装備し、NXP i.MX 6QuadPlus SoC用のカーネル(4.1.15)とブートローダーソースコードまたは、NXP i.MX 6Quad SoC用のカーネル(3.10.53)とブートローダーソースコードを含む、システムイメージの作成のためのユーザ用ガイドが付属します。このBSPは、最新のHTML5ベースのデジタルサイネージ用アプリケーションを可能にするよう設計され、Chromiumブラウザ上のハードウェアアクセラレートされたビデオデコーディング機能が含まれます。また、ご要望により、ソフトウェアカスタマイズサービスの追加も可能です。

VIA VTS-8589以外にも、VIAは広範囲な市場向けシステム、マン・マシン・インターフェース(HMI)スターターキット、そして車両内や駅構内用に即座にカスタマイズできるIoTを加速するプラットフォームを、Embedded WorldのVIAブースにて展示します。

VIA VTS-8589についての詳しい情報はこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/ja/boards-ja/modules/vts-8589/>

VIAのEmbedded World 2017での展示内容に関する詳しい情報は、下記をご参照ください。

<http://www.viatech.com/ja/embedded-world-2017-ja/>

VIAカスタムIoT設計サービスに関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/ja/services-ja/hw-engineering/arm/custom-design/>

本リリースに関する画像についてはこちらをご覧ください。

<http://www.viagallery.com/vts-8589/>

VIA、Embedded World 2017 において VIA VTS-8589 OPS Board を発表

3/3

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。